

# Hochwertige Fotoeffekte und dynamische AR-Erlebnisse:

## 3D-Sensor von Infineon und pmd bietet branchenweit längste Tiefenmessung

**pmdtechnologies ag**  
The SUMMIT  
Martinshardt 19  
57074 Siegen | Germany  
+49 271 238 712 - 800

[info@pmdtec.com](mailto:info@pmdtec.com)  
[www.pmdtec.com](http://www.pmdtec.com)

**Offices:**  
Siegen | Dresden | Ulm  
San José | Seoul | Shanghai

**Executive Board**  
Dr. Bernd Buxbaum (CEO)  
Dr. Thomas May  
Jochen Penne

**Supervisory Board**  
Martin Buck (Chairman)  
Michael Marhofer (Co-Chairman)  
Simon Evans  
Michael Paintner  
Stefan Schneider  
Andreas Urschitz

**Media Contact**  
Sabrina Buxbaum (Director)  
Marketing & Corporate Strategy  
[s.buxbaum@pmdtec.com](mailto:s.buxbaum@pmdtec.com)

**Social Media**



**München – 27. Oktober 2020** – Gaming, e-Commerce oder 3D-Online-Schulungen: Augmented Reality (AR)-Anwendungen mit dreidimensionalen Bildsensoren verbinden die reale mit der digitalen Welt und werden stark nachgefragt. Infineon Technologies AG und pmdtechnologies haben einen 3D-Tiefensensor auf Grundlage der Time of Flight (ToF)-Technologie entwickelt, der derzeit verfügbare Lösungen übertrifft und ein breiteres Spektrum innovativer Anwendungen im Consumer-Bereich eröffnet. Bis 2024 soll der Markt für 3D-Sensoren in Smartphones weltweit auf mehr als 500 Millionen Einheiten pro Jahr wachsen.

„Der neueste 3D-Bildsensor von Infineon und pmdtechnologies ebnet den Weg für eine neue Generation von Anwendungen“, sagt Philipp von Schierstädt, Senior Vice President Infineon Technologies AG. „Wir ermöglichen intensive AR-Erlebnisse und hervorragende Porträts bei Nacht durch schnelleren Autofokus bei schlechten Lichtverhältnissen sowie Bildsegmentierung. Unsere aktuelle Chip-Entwicklung setzt Maßstäbe, wenn es um Verbesserungen des Imagers, des Treibers und der Datenverarbeitung geht, ebenso im Hinblick auf die hohe Reichweite von zehn Metern bei geringstem Stromverbrauch.“

Der neue Chip wird in miniaturisierte Kameramodule integriert, die eine präzise Bildtiefenmessung im Nah- und Fernbereich für Augmented Reality ermöglichen. Zudem kommt der neue Bildsensor mit 40 Prozent weniger Energie aus als bisher und schont damit den Akku.

### Erweiterte Fotografie-Funktionen und AR mit großer Reichweite

Die flexible Konfigurierbarkeit des neuen REAL3™ ToF-Sensors bietet eine differenzierte Kameralistung bei unterschiedlichsten Bildtiefen, Lichtverhältnissen und Anwendungen. Dank des geringen Stromverbrauchs wird zugleich die Batterielaufzeit des Mobilgerätes verlängert. Je nach Bedarf ermöglicht der neue Sensor Techniken wie Augmented Reality in Echtzeit, Scannen mit großer Reichweite, Rekonstruktion kleiner Objekte, schnellen Autofokus bei geringem Stromverbrauch und Bildsegmentierung. Damit lassen sich Effekte, wie die Unschärfe des Hintergrunds in Videos und Bildern von bewegten Szenen, unkompliziert und unabhängig von Lichtverhältnissen sowie ohne Nachbearbeitung der Aufnahmen realisieren.

**Pioneers from the very beginning.**

**pmdtechnologies ag**

The SUMMIT  
Martinshardt 19  
57074 Siegen | Germany  
+49 271 238 712 - 800

[info@pmdtec.com](mailto:info@pmdtec.com)

[www.pmdtec.com](http://www.pmdtec.com)

**Offices:**

Siegen | Dresden | Ulm  
San José | Seoul | Shanghai

**Executive Board**

Dr. Bernd Buxbaum (CEO)  
Dr. Thomas May  
Jochen Penne

**Supervisory Board**

Martin Buck (Chairman)  
Michael Marhofer (Co-Chairman)  
Simon Evans  
Michael Paintner  
Stefan Schneider  
Andreas Urschitz

**Media Contact**

Sabrina Buxbaum (Director)  
Marketing & Corporate Strategy  
[s.buxbaum@pmdtec.com](mailto:s.buxbaum@pmdtec.com)

**Social Media**



Darüber hinaus ist mit dem Tiefensensor eine nahtlose AR-Erfassung gegeben. Ohne Einbußen bei der Auflösung im kürzeren Bereich ist eine qualitativ hochwertige 3D-Tiefen-Erfassung bis zu einer Entfernung von zehn Metern möglich. „Always on“-Anwendungen wie mobile AR-Spiele profitieren insbesondere von dem geringen Energiebedarf des neuen Sensors, was für die Benutzer längere Spielzeiten als bisher bedeutet. Für Anwendungen wie das 3D-Scannen bei der Raum- und Objektrekonstruktion oder die 3D-Abbildung für die Möbelplanung und andere Designanwendungen bietet der Sensor einen doppelt so großen Messbereich als vergleichbare, aktuelle Lösungen auf dem Markt.

Die Serienauslieferung für den neuen Sensor-Chip beginnt im 2. Quartal 2021, Demo-Kits sind bereits erhältlich.

**Über die pmdtechnologies ag**

Die pmdtechnologies ag, ein fabless IC-Unternehmen mit Sitz in Siegen, Ulm und Dresden (Deutschland) sowie San Jose (USA), Seoul (Korea) und Shanghai (China), ist der weltweit führende Anbieter für CMOS-basierte, digitale 3D Time-of-Flight Bildsensor Technologie. Das Unternehmen wurde im Jahr 2002 gegründet und besitzt über 400 Patente weltweit, die sich mit pmd-basierten Anwendungen, dem pmd-Messprinzip und dessen Umsetzung befassen. 3D-Sensoren von pmd bedienen die Zielmärkte industrielle Automatisierung, Automotive und das breit gefächerte Feld der Consumer Anwendungen wie z.B. in Smartphones.

Weitere Informationen stehen zur Verfügung unter [pmdtec.com](http://pmdtec.com).

**Über Infineon**

Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiter-Lösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von 8,0 Milliarden Euro. Mit der Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.

Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.

Weitere Informationen erhalten Sie unter [www.infineon.com](http://www.infineon.com)